

Echipament tehnologic pentru procesarea in vid a unor straturi subtiri din nitrura de titan (ETPV-SSNT)

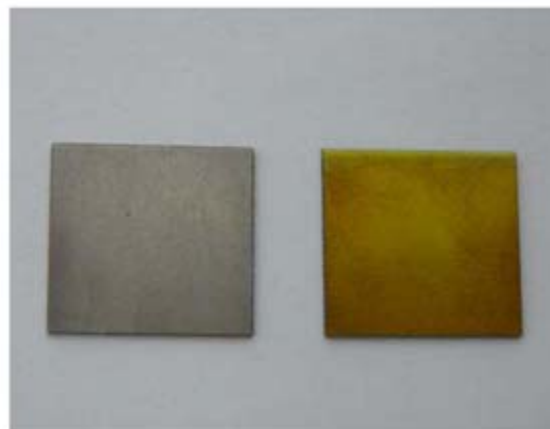
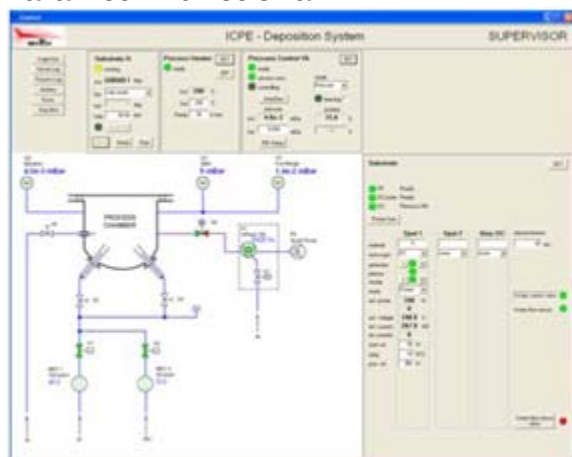
Furnizor/Producator/Service: BESTEC GmbH, Germany



Domeniu de utilizare:

Domeniul depunerii de straturi subtiri in vid, in vederea realizarii de tehnologii de acoperire cu straturi subtiri: decorative, biocompatibile, optice, anticorozive, lubrifiante, antiuzura, etc., prin pulverizare magnetron standard sau de tip reactiv.

Parametrii functionali



- Camera tehnologica din otel inoxidabil amagnetic (45 ± 50 mm si $H = 500 \pm 50$ mm)
- Viteza de rotatie de maxim 30 rot/min pentru portsubstraturi;
 - Presiune limita sub 5.10^{-7} mbar si vid dinamic stabil in intervalul 5.10^{-1} - 5.10^{-4} mbar, in spatiul tehnologic;
 - Doua magnetroane circulare cu tinta de pulverizare de 5 cm;
 - 2 gaze de lucru: Ar-gaz de bombardament si N₂-gaz reactiv;
 - Sursa de cc min. 500W pentru alimentarea unui catod de pulverizare de tip magnetron;
 - Sursa de RF de min. 300W, cu boxa de adaptare a impedantei plasmei pentru alimentarea unui catod de pulverizare de tip magnetron;
 - Sursa de cc-pulsat de min. 500W pentru polarizare a substratului in vederea asigurarii acoperirilor de tip magnetron reactiv;
 - Sursa de incalzire a substraturilor la temperaturi de RT -350°C.